

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2021]29号

关于对 2021 年度“全国半导体材料标准化分技术委员会 技术标准优秀奖”评选结果公示的通知

各会员单位及各位委员：

根据“全国半导体材料标准化分技术委员会技术标准优秀奖”评选要求，经各会员单位申报、秘书处形式审查，共 7 项标准项目进入专家评审。2021 年 10 月 15 日，全国半导体材料标准化分技术委员会在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市召开专家评审会，共评选出技术标准优秀奖 5 项，其中一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 3 项。特此网上公示，并征求各相关单位意见，意见反馈截止日为十一月十二日。

附件：2021 年度“全国半导体材料标准化分技术委员会技术标准优秀奖”
获奖项目名单

二〇二一年十一月四日



附件：

2021 年度“全国半导体材料标准化分技术委员会
技术标准优秀奖”获奖项目名单

序号	项目名称	起草单位	起草人
一等奖			
1	GB 硅单晶中 III、V 族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法	乐山市产品质量监督检验所、青海芯测科技有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司、新特能源股份有限公司、有研半导体硅材料股份公司、四川永祥股份有限公司、陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司、江苏鑫华半导体材料科技有限公司、洛阳中硅高科技有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、江苏秦烯新材料有限公司	梁洪、赵晓斌、万涛、薛心禄、魏东亮、王彬、邱艳梅、李朋飞、赵培芝、王永涛、魏强、楚东旭、周延江、刘文明、刘红、何建军
二等奖			
2	GB 磷化铟单晶	中国电子科技集团公司第十三研究所、云南鑫耀半导体材料有限公司、广东先导微电子科技有限公司、有研国晶辉新材料有限公司	孙聂枫、李晓岚、王阳、刘惠生、惠峰、朱刘、王书杰、邵会民、周铁军、史艳磊、付莉杰、王博、张晓丹、姜剑、王宇
三等奖			
3	GB 集成电路用低密度晶体原生凹坑硅单晶抛光片	有研半导体硅材料股份公司、山东有研半导体材料有限公司、杭州中欣晶圆半导体股份有限公司、南京国盛电子有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、中环领先半导体材料有限公司、浙江海纳半导体有限公司	孙燕、宁永铎、钟耕杭、李洋、徐新华、骆红、张海英、由佰玲、潘金平
4	GB 碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定 二次离子质谱法	中国电子科技集团公司第四十六研究所、山东天岳先进科技股份有限公司	马农农、何友琴、陈潇、刘立娜、何烜坤、张红岩
5	YS 多晶硅行业绿色工厂评价要求	新特能源股份有限公司、四川永祥股份有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司、四川永祥新能源有限公司、宜昌南玻硅材料股份公司	银波、邱艳梅、刘秀兵、呼维军、刘国霞、陈国辉、李寿琴、王彬、于生海、梁哲、李斌、刘文明